

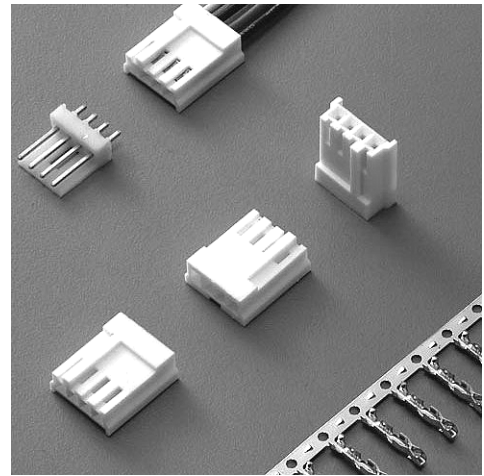
531

Stift- / Buchsenleisten - Crimp-Rast-System - RM 2,54 mm

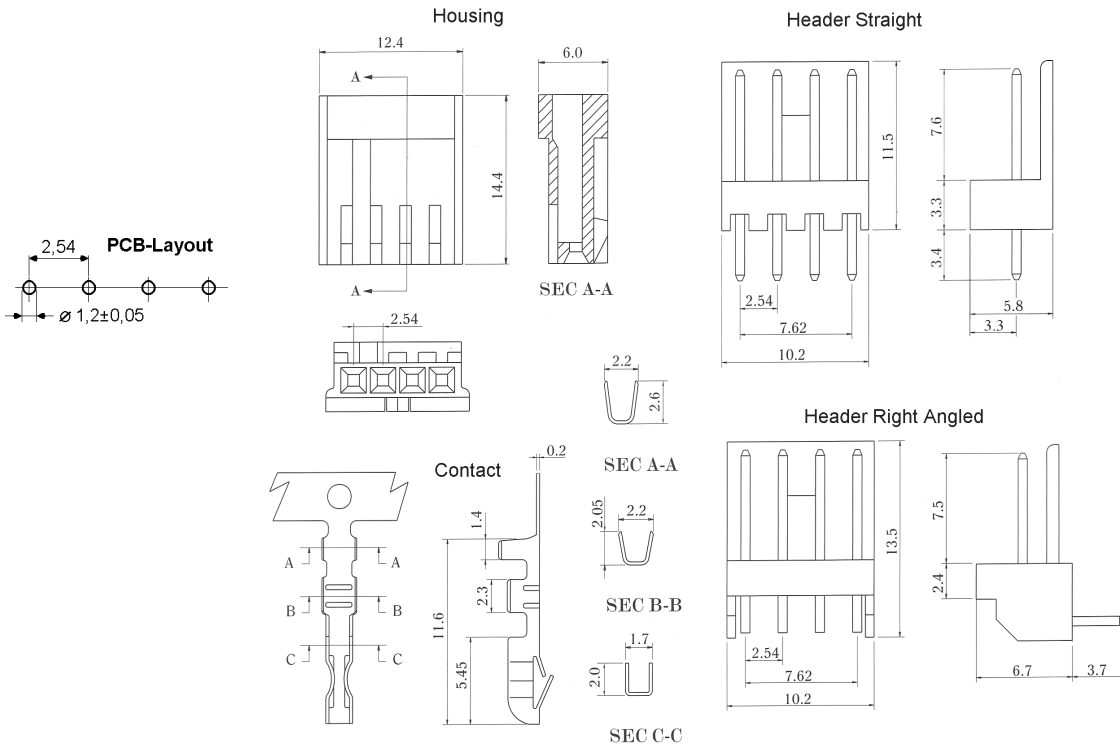
Friction Lock Header and Crimp Housing - Pitch 2,54 mm

Technische Daten / Technical Data:

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94V0
Kontaktmaterial	Messing
Contact Material	Brass
Kabeldurchmesser	AWG 22-26
Applicable wire	AWG 22-26
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Contact Resistance	≤ 20 mOhm
Isolationswiderstand	> 10 ⁹ Ohm
Insulation Resistance	> 10 ⁹ Ohm
Spannungsfestigkeit	1000 V _{AC}
Test Voltage	1000 V _{AC}
Nennspannung	250 V _{AC/DC} max.
Current Voltage	250 V _{AC/DC} max.
Nennstrom	2,5 A
Current Rating	2,5 A
Temperaturbereich	-25°C...+85°C
Temperature Range	-25°C...+85°C
Verarbeitung	Wellen-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Wave-Soldering, further informations in chapter T



© W+P PRODUCTS



K

Series	Contacts	Type*	Plating
531	4 04-pol.	3 1 = Buchsengehäuse Housing 2 = Buchsenkontakte Crimp-Contacts 3 = Stiftleiste gerade Pin Header Straight 4 = Stiftleiste gewinkelt Pin Header Right Angled	50 50 = verzinkt tin plated keine Angabe bei Gehäusen Not Necessary for Housings

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * Order example - To be replaced by your specifications.)

Wellen-Lötverfahren Wave-Soldering

Bauteile sollten bei 260°C für max. 5 Sekunden verarbeitet werden.
Items should be soldered at 260°C for max. 5 seconds.

Empfohlenes Wellen-Lötprofil:
Recommended Wave-Soldering profile:

